

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	国联基金、西部证券、华西证券、财信证券、东方证券、国泰基金、中信证券等 8 位机构投资人
时间	2024 年 7 月 8 日-7 月 9 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司的产品线很丰富，主要有哪些产品？</p> <p>A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。</p> <p>Q2：公司为生产折叠屏的客户 提供哪些设备？</p> <p>A2：公司为生产折叠屏的客户 提供屏幕生产制造设备，主要有绑定设</p>

备、贴合设备、覆膜设备、检测设备及组装设备。公司在折叠屏的绑定技术和贴合技术处于技术领先地位。

Q3: 公司在 Mini/Micro LED 显示领域有推出哪些设备?

A3: 公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域, 已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q4: 子公司深圳市联得半导体技术有限公司主要销售哪些产品?

A4: 公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势, 积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q5: 公司的出海设备市场拓展情况如何?

A5: 在海外市场, 公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源, 并建立了良好的合作关系。公司在该行业的布局逐渐在订单中变现, 特别是公司与国外大客户的深度合作, 实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。

Q6: 公司未来如何继续拓宽销售渠道?

A6: 公司持续推动全球化业务的布局工作, 在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下, 积极开拓海外销售市场。公司凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系, 获得了海外大客户的广泛认可, 并达成了深度合作。未来公司将持续开拓海外销售市场, 进一步拓宽销售渠道, 不断推进公司业务发展, 以良好的经营业绩回报广大投资者。

Q7: 公司未来发展战略是什么?

A7: 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设

	备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发团队模式，形成稳健持续的发展平台。
附件清单（如有）	无
日期	2024-7-9